



Toshiba stellt neuestes Ethernet-Bridge-IC für Automotive- und Industrieanwendungen vor

Das neue IC unterstützt das Time-Sensitive Networking Protokoll und Ethernet Datenübertragungsraten von bis zu 1Gbit/s

Düsseldorf, Deutschland, 22. Januar 2019 – Toshiba Electronics Europe („Toshiba“) stellt mit der Serie TC9562 seine neuesten Bridge-ICs für Fahrzeugnetze vor. Sie zeichnen sich durch fortschrittliche Ethernet-Funktionen für Telematik- und Infotainmentsysteme im Automotive-Bereich aus.

Echtzeitverarbeitung und zuverlässige Datenübertragung sind entscheidend für Telematik-, Infotainment- und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und verschiedene Sensordaten, um vollständig vernetzte Fahrzeuge zu ermöglichen. Neue Standards, einschließlich Ethernet AVB^[1] und TSN^[2], kommen im Automotive- und Industriebereich zum Einsatz, um höhere Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Die TC9562-Serie von Toshiba ist auf Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit ausgelegt und bietet Ethernet-AVB Bridging-Funktionen mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1Gbit/s. Die neuen Automotive-Bridge-ICs unterstützen auch das TSN-Protokoll (Time Sensitive Networking) für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen.

Die Bausteine unterstützen die Ethernet-AVB-Spezifikation, insbesondere IEEE 802.1AS^[3] und IEEE 802.1Qav^[4] sowie die TSN-Standards IEEE 802.1Qbv^[5], IEEE 802.1Qbu und IEEE 802.3br^[6]. Sie unterstützen außerdem zahlreiche Schnittstellen, darunter PCI Express[®] 2.0 und 1.0, I2S/TDM, RGMII, RMI, MII^[7] und eine Option für SGMII^[7] für erweiterte Schnittstellen zu verschiedenen IVI-SoC Lösungen, sowie zu Audio-TDM-Codex

„Wir haben mit Toshiba zusammengearbeitet, um deren Ethernet-Bridge-ICs in unsere Qualcomm®-Snapdragon™-820A-Plattform zu integrieren“, erklärte Shyam Krishnamurthy, Senior Director bei Qualcomm Technologies. „Wir freuen uns nun auf die weitere Zusammenarbeit, um gemeinsam neueste Lösungen für fortschrittliche Cockpit- und Telematikanwendungen in Fahrzeugen entwickeln zu können.“

Armin Derpmanns, General Manager Semiconductor Marketing bei Toshiba Electronics Europe, fügte hinzu: „Mit der Erweiterung unserer erfolgreichen Serie von Automotive-Ethernet-Bridge-ICs hoffen wir, dass wir die Einführung von Ethernet im Fahrzeug beschleunigen können.“

Die Serie TC9562 wird Automotive-qualifiziert^[8] und hat ein 9 mm x 9 mm P-LFBGA-Package. Muster stehen ab Februar 2019 zur Verfügung; die Volumen-Fertigung beginnt im Oktober 2019.

Weitere Informationen und Details unter: <https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/automotive/interface-bridge.html>

Anmerkungen:

[1] Ethernet AVB: IEEE802.1 Audio/Video-Bridging

[2] Ethernet TSN: IEEE802.1 Time Sensitive Networking

[3] IEEE 802.1AS: Standard für die Zeitsynchronisation

[4] IEEE 802.1Qav: Standard für Traffic Shaping

[5] IEEE 802.1Qbv: Standard für 'Enhancements to Scheduled Traffic'

[6] IEEE 802.1Qbu/IEEE 802.3br: Standard für Frame Preemption/Interspersing Express Traffic

[7] SGMII, RGMII, RMII, MII: Ethernet-Schnittstelle. SGMII = Serial Gigabit Media Independent Interface; RGMII = Reduced Gigabit Media Independent Interface; RMII = Reduced Media Independent Interface; MII = Media Independent Interface

[8] AEC: Automotive Electronics Council. Die neuen Bridge-ICs werden nach AEC-Q100 Grad 3 qualifiziert sein

*Qualcomm und Snapdragon sind Warenzeichen der Qualcomm Incorporated, registriert in den USA und in anderen Ländern. Qualcomm Snapdragon ist eine Marke der Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften.

* Arm und Cortex sind eingetragene Warenzeichen der Arm Limited (oder einer seiner Tochtergesellschaften) in den USA oder in anderen Ländern.

* PCI Express und PCIe sind eingetragene Warenzeichen der PCI-SIG.

* Alle anderen Firmen-, Produkt- und Service-Namen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASICs, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland

Tel: +49 (0) 211 5296 0

Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: solution-marketing@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com